

Willkommen bei o-führend

Wir sind professioneller PCB-Hersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrungen. Produkte Range-Single, doppelt seitlich, mehrschichtige PCB, flexible PCB und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototyp-Service - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schäder in der 48-96-Arbeitszeit-Produktionszeit bereitstellen.

Kupferplattenlöcher Minimum .025 AVG, 0,020 min .. Löcher dürfen nicht angeschlossen werden

Packen Sie mit farblosen transparentem Blasenfilm, 25 PCs / Beutel, Trockenmittel in Flanke geben, Feuchtigkeitsanzeigekarte auf der Oberseite setzen

Produktbeschreibung

[Hersteller von Leiterplatten](#)

[PCB-Board-Hersteller China](#)

[PCB-Prototyphersteller China](#)

Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-führend
Grundmaterial	EN-4, Aluminium	Kupferdicke.	0,5 oz-oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenveredelung.	Gold Immersion, OSP, Bleifreier Hasl	Dicke des Boards.	0,1 bis 5 mm
Anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerung PCB.
Zertifikate	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / ctn.	10pcs-100pcs.
Gewicht	0,01 kg-5 kg	Moq.	10pcs.
Farbe	Blau, rot, grün, schwarz. Gelb	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Modell-Nr	Power Bank PCB-Baugruppe PCBA-Hersteller	Größe	0,01 m3-10.
Art des Trokles.	Anforderung des Kunden.	Mindest. Abstand der Linien	0,2 mm

Verpackung und Lieferung.

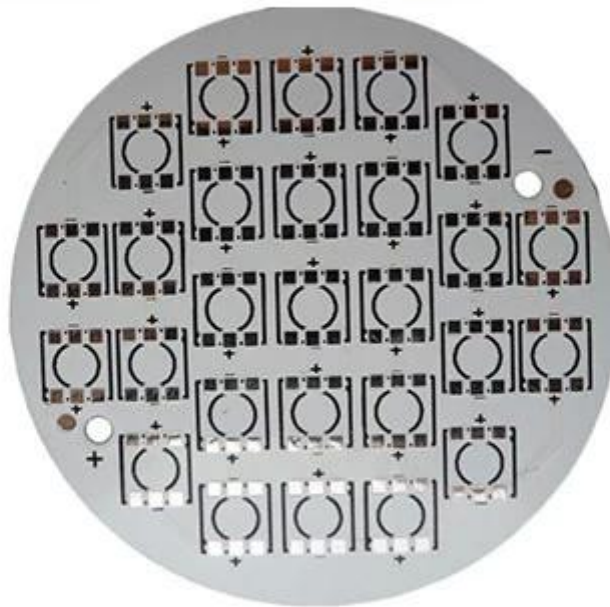
Verpackungsdetails:	16 Jahre professioneller PCB-OEM-Kartenhersteller
Lieferdetails	7-12days.

Beschreibung des Produkts

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenbrettherstellung

Punkt	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Volumen	Stichprobe	Volumen	Stichprobe	Volumen	Stichprobe
Anzahl der Schichten	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Min / Raumlinie (µm)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40.	35/35.

Mindestbohrloch Durchmesser (mm)	0,15.	0,10.	0,15.	0,10.	0,15.	0,10.
Seitenverhältnis von Pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1.	18: 1.	20: 1
n + c + n	4 + c + 4	5 + c + 5	5 + c + 5	6 + c + 6	5 + c + 5	6 + c + 6
Jede Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung durch	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Mindest. Kernstärke (Kupfer ausschließen) µm	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Min-Laserbohrer. Durchmesser (µm)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Via auf begraben Loch / gestapelt über	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Material	FR4, MEGTRON, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Integrierter Kondensator PCB.	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Oberflächenprozess	Bleifreier Hasl, enig, osp, Immersion Silber, Tauchzinn, Gold des Blitzes, goldene Fingerplattierung, selektive harte Goldplattierung, Abziehbare Schweißmaske, Carbon-Tinte					



www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

Unser Team





Zertifizierungen



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [iQ™ Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp			UL796		
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Huileyer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
Huileyer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

Implications: Using this information to verify the accuracy of the data is the user's responsibility. ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Hexabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Heptabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Octabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Nonabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Decabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is a global leader in testing, inspection and certification services. We are committed to providing our clients with the highest quality of service and the most accurate and reliable results. Our services are recognized by the international community and are a key factor in the success of many of the world's leading companies. For more information, please visit our website at www.sgs.com.

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-PCB-Board-Hersteller
Lieferungsdetails.	7-12days.



FAQ

1. Wie sorgen o-leitende Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird folgendermaßen erreicht.

1. Der Prozess wird unter ISO 9001: 2008 strikt gesteuert.
2. extensive Verwendung von Software beim Verwalten des Produktionsprozesses
3. TOSTATE-KUNST-TRESTEN-EQUIPMENTS UND -HOOLEN. Z.B. Fliegende Sonde, Röntgeninspektion, AOI (automatisierter optischer Inspektor) und IKT (In-Circuit-Tests).
4. Dediziertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerkonto-Analyseprozess
5. Kontinuierliches Personal Training und Bildung

2. Wie halten o-führe Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht; Chinesische Währung RMB hatte 31% über US-Dollar geschätzt. Und unsere Arbeitskosten stiegen ebenfalls deutlich an. O-Leder hat jedoch unsere Preisgestaltung festgehalten. Dies gilt ausschließlich unseren Innovationen bei der Verringerung von Kosten, der Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche auf demselben Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist gegenseitig vorteilhaft, wenn wir Ihnen einen Vorteil von Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards können den o-führenden Prozess?

Common FR4, High-TG- und halogenfreie Boards, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupferbücher, PI usw.

4. Welche Daten sind für die PCB-Produktion erforderlich?

Es ist am besten, Daten in Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, Pads, DXP und Eagle auch verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für Multi-Layer-PCB?

Materialschneiden → Innen-Trockenfilm → Innenätzen → Innen-AOI → Multi-Bond → Schicht-Stapel-Up-Pressung → Bohrung → PTH → Paneel-Plattierung → Außen-Trockenfilm → Muster-Plattierung → Außenätzen → Außen-AOI → Lötmaske → Komponentenmarke → Oberfläche → Routing → e / t → Sichtprüfung.